

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Improper hole drilling conditions result in rugged hole wall. Desmear solution or plating solution penetrates along the glass fibers in this part and copper plating takes place on the surface of fibers. (Hole drilling - copper through hole plating process)

5-1-2-10 スルーホールコーナダメージ／通孔拐角的损坏 / Damaged PTH corner

【特徴】 スルーホールランドからスルーホールコーナにかけダメージを受けた様相に変形している状態の欠陥

【特征】 从焊环到通孔的拐角有损坏模样的缺陷。

【Characteristics】 This is a deformation of the land of a PTH due to the damage made to the land at the hole corner.

【原因・判断ポイント・発生工程】 導体回路形成後にスルーホールランド部に何かが接触または衝突したことにより出来たもの（導体回路形成後工程）

【原因、判断要点、发生工序】 图形转移后，焊环接触某种物体或者受冲击而引起的（图形转移后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

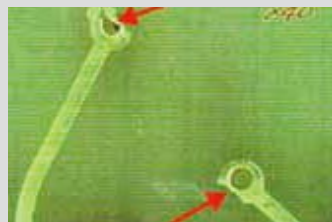
An object was in contact with or hit the PTH land after the conductive pattern is formed. (After formation of conductive pattern)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

5-2 銀スルーホール欠陥／ 银通孔的缺陷 / Silver-paste through-hole defects

5-2-1 銀スル充填不足／银通孔的填充不足 / Insufficient silver paste filling

【特徴】 銀ペーストが表裏の回路を十分に繋いでいない状態の欠陥

【特征】 银膏没有充分地连接表里线路的缺陷。

【Characteristics】 Silver paste does not completely interconnect the patterns on the front side and the back side of a hole.



【コメント】
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50